

# GAP-351F - Serie G6 SERVER RUGGED 3U



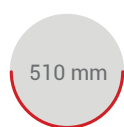
Intel® Xeon® Scalable

I/O Motherboard Frontali e Alimentatore Posteriore



3U

Piattaforma



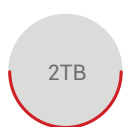
510 mm

Profondità



1-2

CPU



2TB

RAM



3+3

SSD



6

Schede I/O

**GAP** è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

I server rugged GAP-351F Serie G6 integrano singolo o doppio processore della serie Intel® Xeon® Scalable Processors (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) che offre fino a 28 core e 56 thread, fino a 38.5 MB di cache L2, la nuova UPI (Ultra Path Interface), fino a sei canali di memoria, supporto AVX-512 e fino a 48 linee PCIe 3.0. I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità.

GAP-351F è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 3U di altezza e 510mm di profondità. La configurazione con I/O motherboard frontali e alimentatore posteriore consente di disporre di tutte le porte della motherboard e delle schede integrate sul fronte dell'apparato. I server rugged serie GAP-351F possono ospitare tre SSD estraibili, tre SSD interni e un DVD Slim. All'interno possono essere integrate fino a sei schede PCIe. Le schede aggiuntive possono essere provviste di sistemi di fissaggio dedicati per garantire il funzionamento ottimale anche in presenza di shock e vibrazioni o durante il trasporto.

I server rugged GAP sono conformi alle MIL-STD-810F per temperatura e shock, alle MIL-STD-167-1A per vibrazioni e opzionalmente alle normative MIL-STD-461. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

## CARATTERISTICHE

- Server Rugged 3U - 510mm profondità
- Singolo o doppio processore
- Intel Xeon® Scalable (I e II Gen)
- I/O motherboard frontali
- Ingresso di alimentazione posteriore
- Alimentatore Ridondato AC o DC
- Fino a 3 SSD Hot Swap + 3 SSD interni
- DVD opzionale
- Fino a 6 schede PCIe
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

## Specifiche Tecniche

### Sistema

<b>Processore</b>	Famiglia Intel® Xeon® Scalable (fino a 140W TDP) - Doppio Socket P (LGA 3647) - Fino a 28 core Famiglia Intel® Xeon® Scalable (fino a 165W TDP) - Singolo Socket P (LGA 3647) - Fino a 28 core
<b>Memoria</b>	Fino a 2TB ECC RDIMM, DDR4-2933MHz
<b>Chipset</b>	Intel® C621
<b>Porte rete</b>	2 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x RJ45 dedicata IPMI
<b>Storage</b>	2.5" SATA Disk - RAID 0, 1, 5, 10
<b>TPM</b>	1 TPM Header
<b>I/O motherboard</b>	Disponibili sul fronte: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN (Motherboard Doppio Socket) 1 x VGA; 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN, 1 x COM (Motherboard Singolo Socket)
<b>Schede aggiuntive</b>	Fino a 6 Schede PCIe Low profile
<b>Sistemi operativi</b>	Windows® 8.1, Windows® 10 IoT Enterprise 2016, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2016, Linux, Vmware
<b>IPMI</b>	IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail
<b>Monitoraggio remoto</b>	Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID)

### Alimentazione

<b>Alimentatore</b>	100/240 VAC Ridonato 18-36 VDC Singolo o Ridonato 36-72 VDC Singolo o Ridonato
---------------------	--

### Caratteristiche Meccaniche

<b>Dimensioni</b>	483 x 133 x 510 mm
<b>Materiale</b>	Alluminio con trattamento di passivazione superficiale
<b>Colore</b>	Silver
<b>Alloggiamento</b>	Chassis 3U per montaggio a rack 19" Guide telescopiche opzionali
<b>Configurazione</b>	I/O motherboard frontali e alimentatore posteriore
<b>Pannello frontale</b>	Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset
<b>Baie Drive</b>	1 x 5.25" slim; 1 x baia 3.5" + 1 x baia interna x 3 ODD 2.5"

### Parametri Ambientali - (Design to meet)

<b>Temperatura operativa</b>	Standard: 0°C / +50°C Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)
<b>Umidità operativa</b>	Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)
<b>Temperatura storage</b>	-40°C / +70°C
<b>Vibrazioni</b>	MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes
<b>Shock operativo</b>	MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms - half sine
<b>Shock trasporto</b>	MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth
<b>Certificazioni</b>	Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.